

1 主题内容与适用范围

本规范规定了塑封模具中直接影响产品质量的尺寸公差定义、公差极限和检测方法。

本标准适用于塑料封装的集成电路、半导体分立器件和元件等塑封模具。封装材料为热固性塑料，如改性环氧树脂、硅酮塑料等。

2 塑封模具尺寸公差的定义

2.1 型腔尺寸公差

指形成产品的型腔尺寸的允许变动量。

2.2 型腔位置尺寸公差

指确定型腔位置尺寸的允许变动量。

2.3 上、下模型腔错位公差

指上模腔中心位置相对下模型腔中心位置的允许变动量(见图 1)。

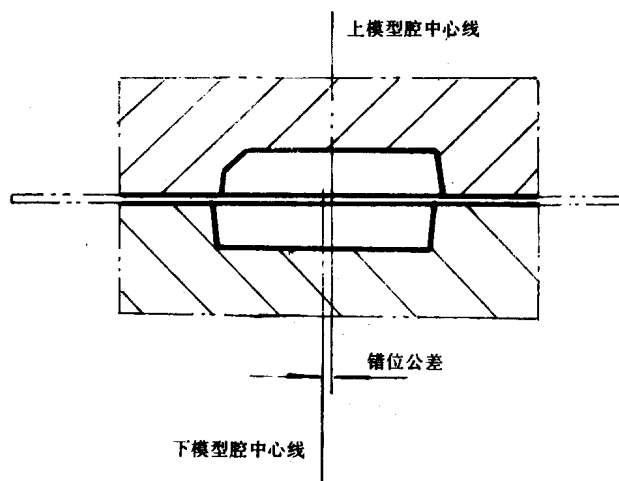


图 1 上、下模型腔错位公差

2.4 引线框架与型腔的错位公差

指引线框架中心相对下模型腔中心位置的允许变动量(见图 2)。该公差不包括引线框架公差。

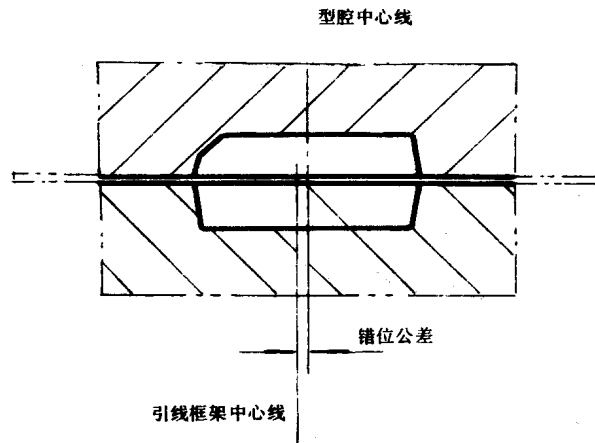


图 2 引线框架与型腔错位公差

2.5 顶杆高出量公差

指顶杆工作端面高于相应型腔面尺寸的允许变动量(见图 3)。

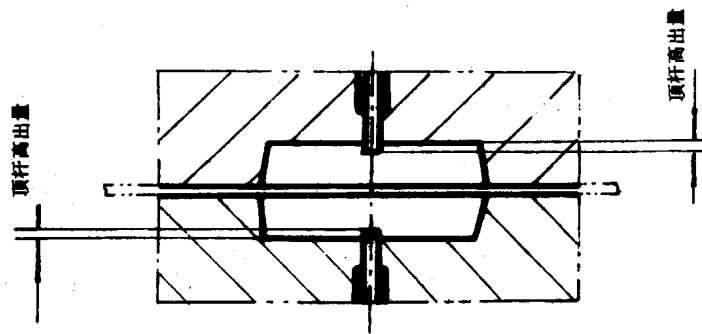


图 3 顶杆高出量公差

2.6 顶杆直径公差

指顶杆直径的允许变动量(见图 4)。

2.7 顶杆孔直径公差

指顶杆孔直径的允许变动量(见图 4)。

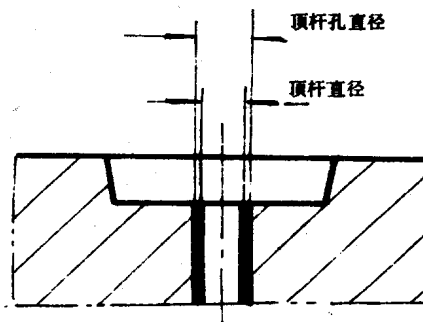


图 4 顶杆和顶杆孔直径公差